

到下一合同年度,不在该合同年度结束后补偿;星科金朋每年只能行使递延权利一次,且该递延部分不得于次年度再递延,最后一合同年度不得行使递延权利。

基于科利玛斯与 SCT1 原有业务量为 1 亿美元左右,且 SCT1、SCT3 运营正常(依赖于科利玛斯订单的支付),要收购并判断其作为业务失败之一(的技术服务协议)的约定了 5 个合同年度的最低采购金额。

2015 年 3 月 25 日开始,个别大客户对科利玛斯控股子公司 SCT1 订单突然下降,导致 SCT1 的采购金额也大幅下滑,2015 年 8-12 月科利玛斯与 SCT1 采购金额仅为 4,406 万美元。

考虑到订单持续需要时间,公司预计未来将根据《技术服务协议》约定的做出补偿,并聘请专业机构对科利玛斯公允价值的支付进行了评估,科利玛斯于 2015 年末计提了约 58,600 万美元的“最低采购承诺”拨备,以反映公允价值的最佳估计。

2、合同的技术协议及剩余未采业务

自 2015 年 8 月 1 日起,科利玛斯对 SCT1 采购金额极低的情况,一方面公司计提了“最低采购承诺”拨备,另一方面公司将对《技术服务协议》履行作为重大项目管理,明确负责人和管理团队解决对 SCT1、SCT3 的采购。

通过引入新客户与新产品措施,2016 年以采科利玛斯对 SCT1 订单开始逐步上升,2016 年 1 个季度订单金额分别为 1300,1,900,1,100,1,800 万美元,合计金额超过 7,000 万美元,加上协议约定的最低采购额逐步递增,预计计划到明年后年度采购金额将加速减少。

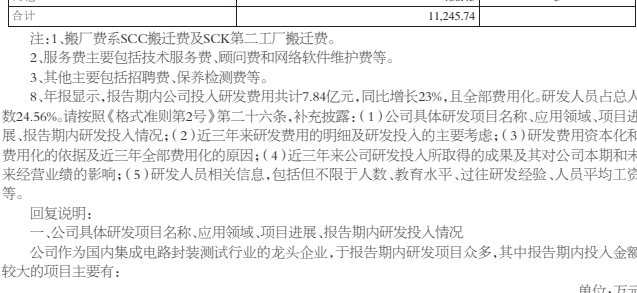
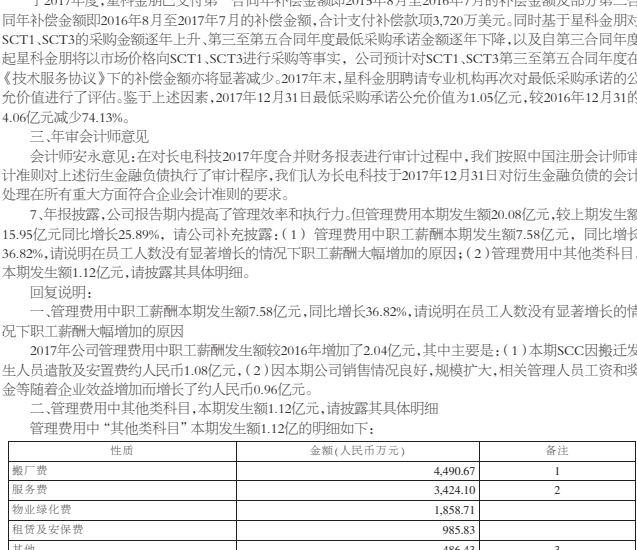
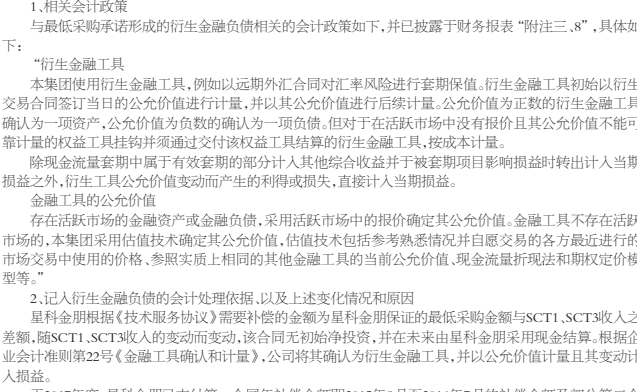
2015 年 8 月 1 日至 2016 年 8 月 1 日的第一合同年度,科利玛斯对 SCT1、SCT3 的采购金额合计为 53,300 万美元,与第一合同年度最低采购金额总额达 4,200 万美元。2017 年 1 月,经协商双方达成一致,科利玛斯最终将 SCT1、SCT3 计提了 3,019.67 万美元,此部分金额冲抵了最低采购承诺拨备的余额。

2016 年 8 月 1 日至 2017 年 8 月 1 日的第二合同年度,科利玛斯对 SCT1、SCT3 的采购金额合计为 56,082 万美

与 C 于 2017 年 6 月底最低采购金额约 2,900 万美元。2017 年 11 月, 经协商双方达成一致, 星科金朋向 SCTL 支付补偿金 1,570 万美元, 此部分金额覆盖了最低采购承诺违约的全部成本。

结合上述订单采购实际情况以及星科金朋向 SCTL 支付补偿金的背景情况, 鉴于星科金朋对 SCTL 的采购金额逐年上升, 第三至第五年度最低采购承诺金额逐年下降且自第三年度起星科金朋对于市场价格向 SCTL 支付进行采购事实, 公司认为对 SCTL 支付 SCTL 预提的最低采购承诺风险已逐步释放, 剩余未支付补偿金额较低。

二、请公司补充说明相关会计政策、上述协议安排对发行人衍生金融负债的会计处理依据, 以及上述变化情况和原因



项目名称	项目进展	2017年研发投入情况
项目一	已完成	6,676.27
项目二	进行中	4,742.66
项目三	进行中	3,749.49
项目四	进行中	3,431.58
项目五	进行中	3,266.34
项目六	进行中	2,384.00
项目七	进行中	2,063.37
项目八	进行中	2,009.58
项目九	进行中	1,998.06
项目十	已完成	1,953.30
合计		32,261.58

上述项目集中于集成电路封装及测试领域，主要应用于通讯、汽车电子、智能移动终端等产品。2017年公司持续加强先进封装装测技术的领先优势，并通过对各种先进研发项目实施来现实产业链下游的多样化应用，用于5G/毫米波、网络、存储、高性能计算（HPC）、MEMS/传感器和汽车应用等的项目包括封装尺寸超过10mm先进封装节点技术的高端封装产品，高密度（HD）封装型晶圆级封装FOWLP（cWLB）的批量生产，先进的ECPC技术，大功率产品和高度集成的3D SiP封装。为满足客户的需求并为其新兴应用和市场做好技术准备，公司将继续寻求开发旗舰产品，例如SiP、封装型晶圆级封装FOWLP（cWLB、ECP）和先进封装技术。

(Flip Chip)混合封装。

2.近三年研发费用的明细及研发投入的主要考虑

2015年、2016年及2017年,公司研发费用的明细如下:

项目	2015年	2016年	2017年
人员工资费用	14,350.57	23,474.96	30,662.05
直接材料费用	23,730.59	22,999.85	27,843.03
折旧与长期摊销费用	8,837.56	11,510.37	14,132.83
无形资产摊销费用	640.87	1,827.72	1,957.40

委托外部研究并开发费用	19,885	460,50	461.47
其他费用	1,760.15	3,514.92	3,379.40
合计	96,513.59	63,783.82	78,436.17

国内产品研究开发方向主要是按照公司整体发展战略要求执行,公司在持续研发投入计划下,紧密结合国内各大高校、科研院所共同研发逐步的加大研发投入,提升研发能力,紧跟国内产品技术发展的步伐,加强创新,不断提升自身的研究能力和产品的技术水平;同时加强公司的知识产权保护。

三、研发费用资本化和费用化的依据及近三年全部费用化的原因

根据《企业会计准则第6号——无形资产》

“第六条 企业内部研究开发项目的支出,应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获得并理解新的科学技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

第七条 企业内部研究开发项目的支出,应当于发生时计入当期损益。

第九条 企业内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产:

- (一)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (二)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (三)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
- (四)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (五)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。”

公司研发的主要课题是对市场客户需求开展新一代半导体封装的新技术的研究。由于近年来的发展成为中国带来经济利益具有一定确定性, 不满足会计准则对研发支出资本化的有关规定, 因此公司近三年所有研发支出全部计入当期费用。

四、近三年来自研发人员所取得的成果及对对公司本期和未来经营业绩的贡献

1、近三年来自研发人员取得的成果

近三年, 公司通过持续的科研投入和技术创新, 取得了丰硕的成果。截至2017年12月31日, 公司已获得专利3,504项, 其中发明专利2,743项(含美国发明专利1,758项), 基于高深技术中高端封装技术, 公司前高深技术封装技术领域(与国外领先企业全球发展), 公司掌握并实现大规模生产的先进封装技术包括Fan-out、WLP、WLCP、Bumping、SiP等, 先进封装技术份额约90%, 占1/8的专利类清单。

公司为中国及美国增加两大研究中心, 中国的研究中心, 领域覆盖芯片封装、MIS封装、SiP封装以及

企业内部产品系统更新,新加坡的两个研发中心领域覆盖FOWIP(eWLB)、SiP及FC等。目前上述研发中心均有多款产品进入量产或即将客户认证。

2、上述研发成果对公司本年及未来业绩的影响

公司近年来的研发成果集中在集成电路封装与测试领域,上述研发成果使得公司在中高端封装测试类是其先进封装领域处于领先地位,同时也有多款产品成功导入并实现量产,为公司的营业收入增长提供有力支撑。未来,公司将继续进行技术创新,持续对技术研发投入,提升公司产品价值,增强市场竞争力。

五、研发人员相关信息

学历	人数
博士	12
硕士	227
本科	2,061
大专	2,573
其他	853
合计	5,726

其中,主要核心技术人员经历如下:

姓名	职务
----	----

[illegible]

(下转B26版)